

보도설명자료

(’23. 2. 28.)

수신 : 산업통상자원부 등록기자

제목 : 정부는 업계와 긴밀히 소통하면서 다양한 채널을 통해 주요
반도체 통상현안에 적극 대응하고 있음

(2.27일 조선비즈 「뿔뿔 뭉치는 美·日·대만, 침묵하는 韓... “칩4’서
희생양 될 수도」 보도에 대한 설명)

1. 보도 내용

- 국내 반도체 업계에서는 정부가 주도적인 역할을 해주기를 바라는 분위기지만 정작 정부는 이렇다 할 목소리를 내지 않고 있음

2. 동 보도 내용에 대한 입장

- Fab4는 한국, 미국, 일본, 대만 등 4자간 다자 회의체로서 각 국의 이해관계가 달라 가드레일 등 양자 이슈를 논의하기에는 적절치 않음
- 정부는 미국 반도체지원법의 가드레일 조항* 등 반도체 통상 이슈 해결을 위해 적극적이고 주도적으로 논의해 왔음

* 미국 반도체지원법상 인센티브를 수령하는 기업은, 인센티브의 반대급부로서 중국 등 우려 대상국에서의 생산능력 확장을 10년간 제한하는 협약을 미 상무부와 체결토록 함

- 업계와의 긴밀한 소통을 거쳐 우리측 입장을 마련, 이의 반영을 위해 美 관계당국과 화상회의, 訪美 면담 등 긴밀히 지속적으로 협의하고 있는 중임
- 특히, 최근(2.15~2.17)에는 산업부 1차관이 미국을 방문, 상무부·백악관 고위관계자 등에게 주요 반도체 통상현안과 관련한 우리 입장을 적극 개진하였음

※ 문의 : 이규봉 반도체과장(044-203-4270), 차세운 서기관(4271)
이승헌 미주통상과장(044-203-5650), 권태성 사무관(5657)